⑩ 日本国特許庁 (JP)

① 特 許 出 願 公 開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭58—222521

50Int. Cl.3 H 01 L 21/20 21/263

識別記号

庁内整理番号 7739-5F 6851-5F

❸公開 昭和58年(1983)12月24日

発明の数 審査請求 未請求

(全 3 頁)

毎半導体膜の形成法

②特 願 昭57-105156

②出 願 昭57(1982)6月18日

72)発 明 者 関口金孝 所沢市大字下富字武野840シチ ズン時計株式会社技術研究所内

⑪出 願 人 シチズン時計株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番

1号

明 細

1. 発明の名称

半導体膜の形成法

2. 特許請求の範囲

- 半導体製造工程におけるレーザーアニールに 於て、2つ以上のレーザ光を用いる事を特徴とす る半導体膜の形成法。
- レーザー光は、1センチメートル以下の照射 距離である事を特徴とする特許請求の範囲第1項 記載の半導体膜の形成法。
- (3) レーザー光は発振モードが、ガウシアンモー ドである事を特徴とする特許請求の範囲第1項記 載の半導体膜の形成法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、半導体膜のレーザーアニーリングに 関する。

現在、レーザーアニール技術は、半導体膜の特 性改善に利用されようとしている。内容は、イォ ンインプラ後の欠陥除去、低温形成した半導体膜 の結晶化、不純物ドーピングの際の活性化、絶縁

膜上への結晶化半導体膜形成等である。この内の 結晶性の改善として、基板に凹凸を形成し、形状 効果を利用しようとする方法及び、種結晶を利用 する方法等があるが、現在までの所まだ十分なレ ーザーアニール技術は確立されていない。また、 以上の2つの方法は、工程面及び、基板の制約も あり、広く応用できる技術ではない。

最近、レーザーアニール技術において、レーザ 一照射部での冷却過程が、結晶性に大きく影響し、 照射部で内側より冷却された場合に、結晶性及び、 表面の凹凸等のない膜が得られるという報告があ る。

本発明は、2つ以上のレーザー光を利用し、結 晶性を改善し、低温で形成した半導体膜の特性向 上をはかるものである。

低温での半導体膜形成法としては、プラズマ或 は、低圧における化学蒸着法(CVD法)及び、 物理蒸着法(PVD法)さらに高真空を利用した 分子線蒸着法(MBD法)等がある。

低温で形成した半導体膜は、結晶性が悪く、単

結晶膜に比べて、電気的特性等において劣ってお り、改善が必要とされている。そこで、2つ以上 のレーザー光を利用し、照射部の温度制御を行な い、結晶性を改良する。結晶性をよくするのに必 要な、温度制御として、レーザー照射部での冷却 が中心より起こり、結晶成長が、中心から周囲に 広がる事が必要である。この1つの方法として、 レーザーの発振モードを変えたり、共振器のミラ - の改造等により、レーザー光の形状を変えて、 レーザーアニールを行なう方法があるが、発振が、 ガウシアンモードと比較して、不安定であり、連 続発振による不安定性によるレーザーアニール膜 の不均一性の問題がある。そこで本発明では、2 つ以上のレーザー光を組み合せ、レーザー光の形 状変化を利用した場合よりも安定で、かつ、照射 部の中心から周囲に結晶化が進み、安定に、結晶 性の優れたレーザーアニールを行なう事ができる。 次に、本発明のレーザーアニールの一実施例を 図を用いて詳細に説明する。

第1図は、レーザー光の組み合せによるエネル

半導体膜を形成した図であり、11が基板、12 が半導体膜、例えば、シリコン、ゲルマニウム等 である。第2図Bは、半導体表面をレーザーアニ ールしている図であり、レーザーの照射は、半導 体膜上から、或は、基板面上から行なってもよい。 13は、レーザーアニールを表わしている。12 は、レーザーアニールを行なった半導体膜である。 第2図Cは、レーザーアニールした膜12上へソー ス或は、ドレイン電極を形成した図であり、14 は、ソース或は、ドレイン電極である。第2図D は、半導体膜の活性領域部、つまり、ソース或は、 ドレイン電極間上へゲート絶縁膜を形成した図で あり、15が、ゲート絶縁膜である。第2図Eは、 ゲート絶縁膜15上ヘゲート電極を形成した M O S (金属酸化膜半導体)型半導体素子を示し た図であり、16が、ゲート電極である。

第3図は、レーザー光の分岐或は、合成の実施例を示す説明図である。第3図Aは、1つのレーザー光東をピイームスプリッタで2つに分離し、反射板例えばアルミニウム板で反射させビームを

ギー強度を示した分布図である。

第1図Aは、ガウシアンモードのレーザー光のスポットの径方向のエネルギー強度分布を表わし、1が、分布曲線である。第1図Bは、レーザー光の中心を d だけ離し、第1図Aの強度のレーザー光を照射した場合のレーザー強度であり、2が、合成したレーザー強度曲線を表わしている。第1図Cは、レーザー光を3箇所に照射し、かつ、中央部のレーザー光強度を弱くした場合をあらわしている。レーザー光の中心は、e だけ離し、合成したもので、3は、中央部に照射したレーザー光強度、4は、合成されたレーザー強度をあらわしている。

レーザー光は第1図Bにおける照射距離d、第1図Cにおける照射距離eを、1cm以下にすることにより分布の重なりを得ることが必要である。第2図は、本発明のレーザーをアニールに利用した半導体素子製造工程の一実施例を示す断面図である。

第2図Aは、ガラス或はセラミックス基板上に

基板上で合成させた図であり、21がレーザー光であり、22がピイームスプリッタであり、23が反射板である。第3図Bは、2つのレーザー光を反射板を用い基板上で合成した図であり、25及び25がレーザー光であり、25及び26がレーザー光であり、27が基板である。第3図Cは、ダブルイメージプリズム、例えば、Wollastonである。第3図Cに於いて、28は、そか岐し、各レーザー光を反射板を用い、基板上で合成した図である。第3図Cに於いて、28は、Wollaston、30及び30は、反射板であり、31は、基板である。

以上の方法を利用する事により、レーザー光を 色々な強度分布を有する形状に合成でき、レーザ ーアニール法に広い応用性を持たせる事ができる。 図面の簡単な説明

第1図A)、第1図B)、第1図C)は、それぞれ異るレーザー光の組み合せにより生ずるエネルギー強度を示した分布図、

第2図A)より第2図E)は、本発明の合成したレーザー光を利用した半導体素子製造法の工程を示す断面図、

第3図A)より第3図C)は、それぞれの分岐 及び合成によりレーザー光が基板に達する状態を 示す説明図である。

1 ……レーザーの強度分布曲線、

2……合成されたレーザーの強度分布曲線、

11……基板、 12……半導体膜、

15……ゲート絶縁膜、 16……ゲート電極、

21、25、25……レーザー光、

22……ピイームスプリッタ、

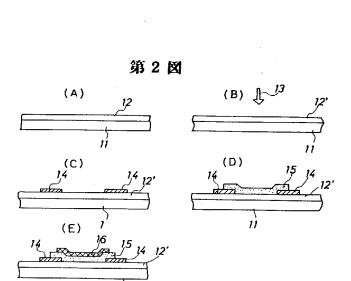
24、27、31……基板、

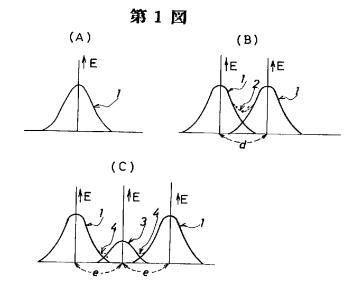
28……Wоllastonプリズム。

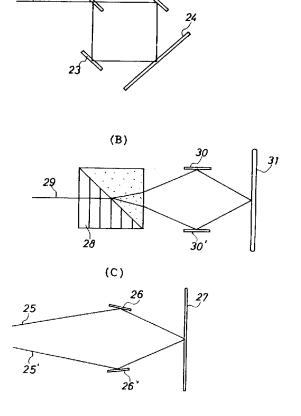
特許出願人 シチズン時計株式会社



第3図







(A)

PAT-NO: JP358222521A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 58222521 A

TITLE: FORMING METHOD FOR SEMICONDUCTOR FILM

PUBN-DATE: December 24, 1983

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

SEKIGUCHI, KANETAKA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

CITIZEN WATCH CO LTD N/A

APPL-NO: JP57105156 **APPL-DATE:** June 18, 1982

INT-CL (IPC): H01L021/20 , H01L021/263

US-CL-CURRENT: 117/43 , 117/904 , 257/E21.134 , 438/530 , 438/FOR.153 , 438/

FOR.334

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve crystallinity, and to enhance the characteristics of the semiconductor film formed at a low temperature by using two or more of laser beams in laser annealing in a semiconductor manufacturing process.

CONSTITUTION: Laser intensity in the case when laser beams are irradiated while the center of laser beams, the distribution of energy intensity thereof is shown in a distribution curve 1, is separated only by (d) is shown in a synthetic curve 2. Distribution is overlapped by bringing a distance of irradiation (d) to 1cm or less in laser beams. Regarding the branch or synthesis of laser beams, one laser luminous flux 21 is separated into two by a beam splitter 22, and reflected by reflector plates such as aluminum plates 23, and beams are synthesized on a substrate 24. The method is more stable than the case of the utilization of a change of form of laser beams, crystallization progresses to the periphery from the center of an irradiating section, and laser annealing of excellent crystallinity can be executed stably.

COPYRIGHT: (C)1983, JPO&Japio